

单 P 沟道 MOSFET

ELM13419CA-S

■ 概要

ELM13419CA-S 是 P 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。另外，此芯片还内藏 ESD 保护电路。

■ 特点

- $V_{ds} = -20V$
- $I_d = -3.5A (V_{gs} = -10V)$
- $R_{ds(on)} < 75m\Omega (V_{gs} = -10V)$
- $R_{ds(on)} < 95m\Omega (V_{gs} = -4.5V)$
- $R_{ds(on)} < 145m\Omega (V_{gs} = -2.5V)$
- ESD 规格：2000V HBM

■ 绝对最大额定值

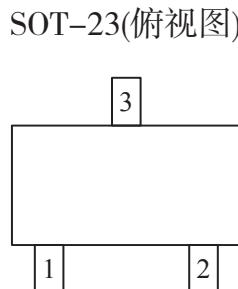
如没有特别注明时, $T_a = 25^\circ C$

项目	记号	规格范围	单位	备注
漏极 – 源极电压	V_{ds}	-20	V	
栅极 – 源极电压	V_{gs}	± 12	V	
漏极电流 (定常) Ta=25°C	I_d	-3.5	A	1
Ta=70°C		-2.8		
漏极电流 (脉冲)	I_{dm}	-15	A	2
容许功耗 Tc=25°C	P_d	1.4	W	1
Tc=70°C		0.9		
结合部温度及保存温度范围	T_j, T_{stg}	-55 ~ 150	°C	

■ 热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
最大结合部 – 环境热阻 t ≤ 10s	$R_{\theta ja}$	65	90	°C/W	1
最大结合部 – 环境热阻 稳定状态		85	125	°C/W	
最大结合部 – 引脚架热阻 稳定状态	$R_{\theta jl}$	43	60	°C/W	3

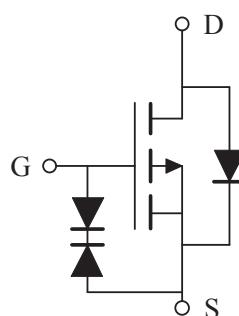
■ 引脚配置图



SOT-23(俯视图)

引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	SOURCE
3	DRAIN

■ 电路图



单 P 沟道 MOSFET

ELM13419CA-S

■电特性

如没有特别注明时, $T_a=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
漏极 – 源极击穿电压	BVdss	$\text{Id}=-250\mu\text{A}, \text{Vgs}=0\text{V}$	-20			V
栅极接地时漏极电流	Idss	Vds=-16V			-0.5	μA
		Vgs=0V	Ta=55°C		-2.5	
栅极漏电电流	Igss	Vds=0V, Vgs= ± 10V			± 1	μA
		Vds=0V, Vgs= ± 12V			± 10	
栅极阈值电压	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=-250 μ A	-0.7	-0.9	-1.4	V
导通时漏极电流	Id(on)	Vgs=-4.5V, Vds=-5V	-15			A
漏极 – 源极导通电阻	Rds(on)	Vgs=-10V		59	75	$\text{m}\Omega$
		Id=-3.5A	Ta=125°C	83	105	
		Vgs=-4.5V, Id=-3A		76	95	
		Vgs=-2.5V, Id=-1A		111	145	
正向跨导	Gfs	Vds=-5V, Id=-3.5A		6.8		S
二极管正向压降	Vsd	Is=-1A, Vgs=0V	-0.65	-0.81	-0.95	V
寄生二极管最大连续电流	Is				-2.0	A
动态特性						
输入电容	Ciss	Vgs=0V, Vds=-10V, f=1MHz		512	620	pF
输出电容	Coss			77		pF
反馈电容	Crss			62		pF
栅极电阻	Rg	Vgs=0V, Vds=0V, f=1MHz		9.2	13.0	Ω
开关特性						
总栅极电荷	Qg	Vgs=-4.5V, Vds=-10V Id=-3.5A		5.5	6.6	nC
栅极 – 源极电荷	Qgs			0.8		nC
栅极 – 漏极电荷	Qgd			1.9		nC
导通延迟时间	td(on)	Vgs=-10V, Vds=-10V RL=2.8Ω, Rgen=3Ω		5.0		ns
导通上升时间	tr			6.7		ns
关闭延迟时间	td(off)			28.0		ns
关闭下降时间	tf			13.5		ns
寄生二极管反向恢复时间	trr	If=-3.5A, dIf/dt=100A/μs		9.8	12.0	ns
寄生二极管反向恢复电荷	Qrr	If=-3.5A, dIf/dt=100A/μs		2.7		nC

备注:

1. $R_{\theta ja}$ 值是在 $T_a=25^\circ\text{C}$ 、使用设置于 2 盎司 FR-4 履铜板上的装置测试所得到的结果。此外，实际阻值还受到电路板设计的影响，并且电流定格依存于 $t \leq 10\text{s}$ 时的热阻定格值。
2. 重复速率和脉冲宽度受结合部温度的控制。
3. $R_{\theta ja}$ 是结合部 – 引脚架热阻与结合部 – 环境热阻的和。
4. 标准特性图 1 ~ 6 是在脉冲为 $80\mu\text{s}$ 、最大占空比为 0.5% 的条件下得到的。
5. 参数是在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，将 IC 设置于 2 盎司 FR-4 履铜板的测试结果。SOA 曲线决定脉冲的定格。



单 P 沟道 MOSFET

ELM13419CA-S

■ 标准特性和热特性曲线

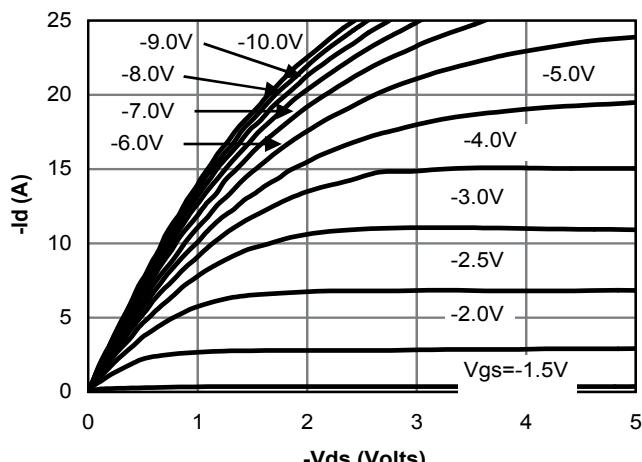


Fig 1: On-Region Characteristics

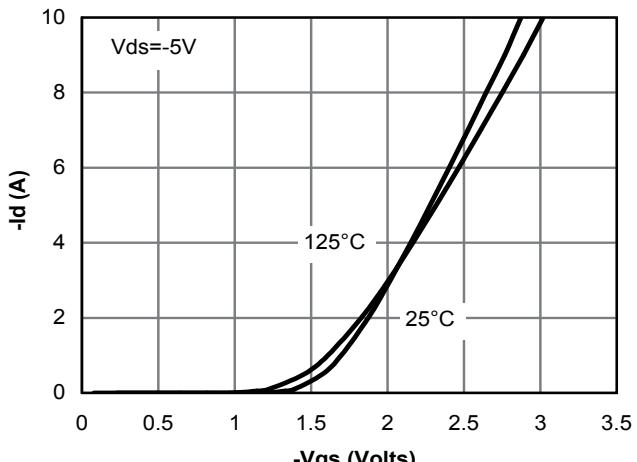


Figure 2: Transfer Characteristics

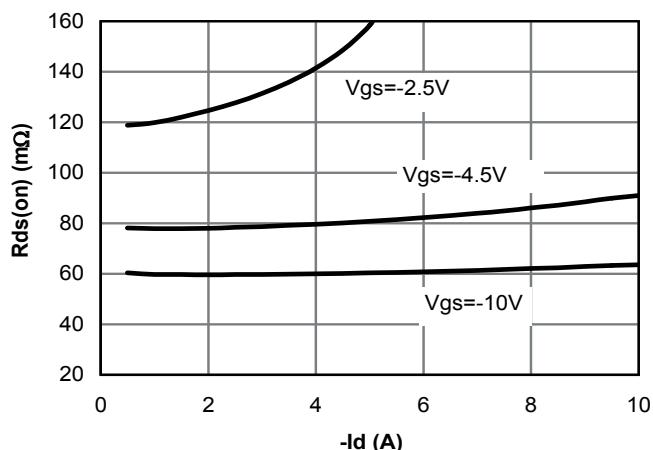


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

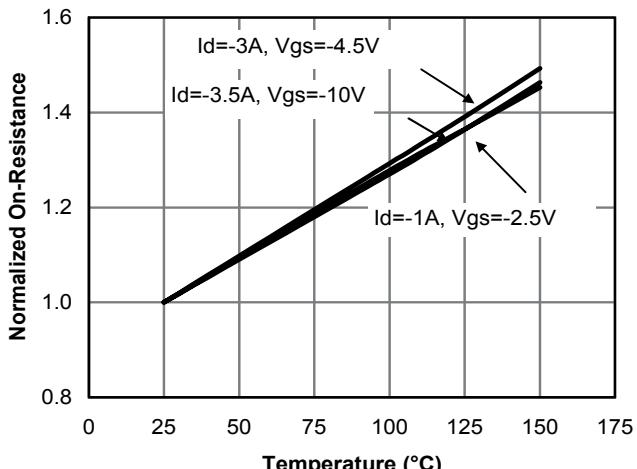


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature

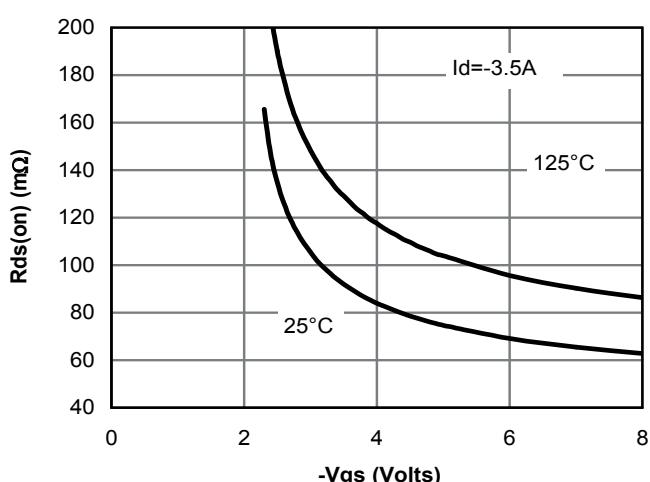


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

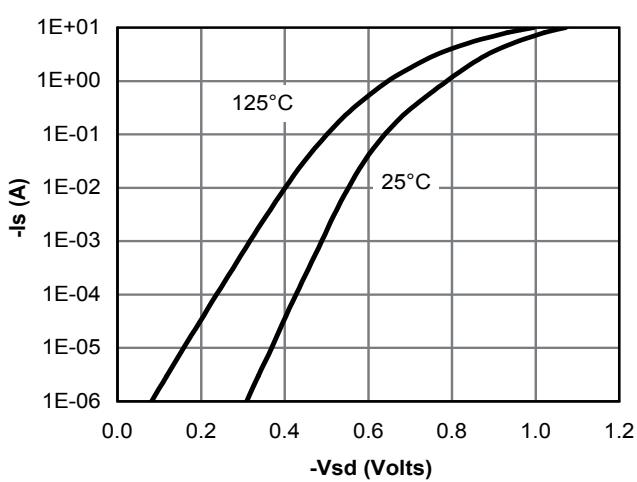


Figure 6: Body-Diode Characteristics

单 P 沟道 MOSFET

ELM13419CA-S

